

省发展改革委省工业和信息化厅关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知

苏发改高技发〔2023〕330 号

各设区市发展改革委、工业和信息化局：

近日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局印发《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287 号，以下简称《通知》）。为指导我省企业做好享受税收优惠政策申请工作，现就有关事项通知如下：

一、切实做好政策宣传

请各地高度重视 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单（以下简称“清单”）制定工作，加大政策宣传力度，组织和指导本地区符合条件的集成电路企业或项目、软件企业准备申报材料，按时登录国家信息填报系统提交申请，确保本地区符合条件的企业应知尽知、应报尽报。

二、企业申报要求

根据《通知》要求，2022 年已列入清单企业如需享受新一年度税收优惠政策（进口环节增值税分期纳税政策除外），2023 年需重新申报。申请列入清单的企业须于 2023 年 4 月 16 日前在信息填报系统（<https://yyglxxbs.ndrc.gov.cn/xxbs-front/>）中提交申请及相关佐证材料（包括经审计的企业会计报告）。申请企业须准备二份加盖公章的

纸质材料及光盘报送至省发展改革委、省工业和信息化厅确定的接受单位。

三、材料报送及初步审核

省发展改革委、省工业和信息化厅根据《通知》规定的企业条件和项目标准，对企业申报信息进行初核通过后，报送至国家发展改革委、工业和信息化部。

省发展改革委、省工业和信息化厅委托省半导体行业协会、省软件行业协会分别作为集成电路企业或项目、软件企业的申报材料接受单位。企业具体填报事宜可咨询省半导体行业协会、省软件行业协会。

集成电路企业或项目二份纸质申报材料、光盘请报送至江苏省半导体行业协会。

联系人：胡建 138061821160510-81190090

邮箱：wh190@163.com

地址：无锡市建筑西路 777 号集成电路设计园 A10 楼 201 室，邮编：214072

软件企业二份纸质申报材料、光盘请报送至江苏省软件行业协会。

联系人：何满怀 13851662078，黄飞 15051837449

邮箱：523410883@qq.com

地址：南京市玄武大道 699-8 号徐庄软件园研发一区 2 栋 1 楼省软协 107 室，邮编：210003

附件：关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、
软件企业清单制定工作有关要求的通知（发改高技〔2023〕287 号）

江苏省发展改革委

江苏省工业和信息化厅

2023 年 3 月 27 日

（联系人：吴岱；025-83390187）

国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知

发改高技〔2023〕287 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、财政厅（局），海关总署广东分署、各直属海关，国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局：

为促进我国集成电路产业持续健康发展，根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号，以下简称《若干政策》）及其配套政策有关规定，经研究，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单（以下简称“清单”）制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。现就有关事项通知如下：

一、本通知所称清单是指《若干政策》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含）、线宽小于65纳米（含）、线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业或项目的清单；《若干政策》第（三）、（六）、（七）、（八）条和《财政部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》（财关税〔2021〕4号）、《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》（财关税〔2021〕5号）提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电

路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业，集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业，集成电路重大项目和承建企业的清单。

二、2022 年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策（进口环节增值税分期纳税政策除外），2023 年需重新申报。申请列入清单的企业应于 2023 年 3 月 25 日至 4 月 16 日在信息填报系统（<https://yyglxxbs.ndrc.gov.cn/xxbs-front/>）中提交申请，并生成纸质文件加盖企业公章，连同必要证明材料（电子版、纸质版）报本省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委或工业和信息化主管部门（由地方发展改革委确定接受单位）。经审计的企业会计报告须在提交申请时一并提交。

三、地方发改和工信部门根据企业条件和项目标准（附后），对企业申报的信息进行初核通过后，报送至国家发展改革委、工业和信息化部。《若干政策》第（一）、（三）、（六）、（七）条，以及财关税〔2021〕4 号文提及的集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业清单，由国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局进行联审确认并联合印发。《若干政策》第（八）条提及的集成电路重大项目，由国家发展改革委、工业和信息化部形成清单后函告财政部，财政部会同海关总署、税务总局最终确定。

四、清单印发前，企业可依据税务有关管理规定，先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策。清单印发后，如企业未被列入清单，应按规定补缴已享受优惠的企业所得税款。申请享受《若干政策》第（一）、（三）、（六）、（七）条，以及财关税〔2021〕4号文提及的关税优惠政策的，可于汇算清缴结束前，从信息填报系统中查询是否列入清单。享受《若干政策》第（八）条优惠政策的，由企业所在地直属海关告知相关企业。

五、已享受《若干政策》第（一）、（三）、（六）、（七）条，以及财关税〔2021〕4号文提及的关税优惠政策的企业或项目发生更名、分立、合并、重组以及主营业务重大变化等情况，应及时向地方发改和工信部门报告，并于完成变更登记之日起60日内，将企业重大变化情况表和相关材料报送国家发展改革委、工业和信息化部（以省级部门上报文件落款日为准）。国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门确定发生变更情形后是否继续符合享受优惠政策的企业条件或项目标准。

六、地方发改和工信部门会同财政、海关、税务对清单内的企业加强日常监管。在监管过程中，如发现企业存在以虚报信息获得减免税资格问题，应及时联合核查，并联合上报国家发展改革委、工业和信息化部进行复核。国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门复核后，对确不符合享受优惠政策条件和标准的企业或项目，将函告财政部、海关总署、税务总局按相关规定处理。

七、企业对所提供材料和数据的真实性负责。申报企业应签署承诺书，承诺申报如出现失信行为，则接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理，涉及违法行为的信息记入企业信用记录，纳入全国信用信息共享平台，并在“信用中国”网站公示。

八、本通知自印发之日起实施，并适用于企业享受 2022 年度企业所得税优惠政策和财关税〔2021〕4 号文规定的进口税收政策。国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门，根据产业发展、技术进步等情况，对符合享受优惠政策的企业条件或项目标准适时调整。

附件：

- 1.享受税收优惠政策的企业条件和项目标准
- 2.重点集成电路设计领域和重点软件领域
- 3.享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表
- 4.企业重大变化情况表

国家发展改革委

工业和信息化部

财政部

海关总署

税务总局

2023 年 3 月 17 日

附件 1

享受税收优惠政策的企业条件和项目标准

一、《若干政策》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含）、线宽小于 65 纳米（含）、线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业或项目享受税收优惠政策条件如下：

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）汇算清缴年度，具有劳动关系或劳务派遣、聘用关系，其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 30%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 20%（从事 8 英寸及以下集成电路生产的不低于 15%）；

（四）企业拥有关键核心技术和属于本企业的知识产权，并以此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于 2%（本条及下述研究开发费用政策口径，按照《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第

40 号) 的规定执行);

(五) 汇算清缴年度集成电路制造销售 (营业) 收入占企业收入总额的比例不低于 60%;

(六) 具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力;

(七) 汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为;

(八) 对于按照集成电路生产项目享受税收优惠政策的，项目主体企业应符合相应的集成电路生产企业条件，且能够对该项目单独进行会计核算、计算所得，并合理分摊期间费用。

二、《若干政策》第 (三) 、 (七) 条提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业享受税收优惠政策条件，除符合《中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告 2021 年第 9 号》规定的国家鼓励的集成电路设计企业条件外，还应符合以下条件：

(一) 汇算清缴年度具有劳动关系或劳务派遣、聘用关系，其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 50%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 40%;

(二) 拥有关键核心技术，并以此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售 (营业) 收入 (主营业务收入与其他业务收入之和) 总额的比例不低于 6%;

(三) 汇算清缴年度集成电路设计 (含 EDA 工具、 IP 和设计

服务,下同)销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于70%,其中集成电路自主设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于60%;对于集成电路设计销售(营业)收入超过50亿元的企业,汇算清缴年度集成电路设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于60%,其中集成电路自主设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于50%;

(四)企业拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权,企业拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利(企业为第一权利人)、布图设计登记、计算机软件著作权合计不少于8个。

除以上条件外,还应至少符合下列条件中的一项:

(一)汇算清缴年度,集成电路设计销售(营业)收入不低于5亿元,应纳税所得额不低于3000万元;对于集成电路设计销售(营业)收入不低于50亿元的企业,可不要求应纳税所得额,但研究开发费用总额占企业销售(营业)收入(主营业务收入与其他业务收入之和)总额的比例不低于8%。

(二)在国家鼓励的重点集成电路设计领域内(附件2),汇算清缴年度集成电路设计销售(营业)收入不低于3000万元,应纳税所得额不低于350万元。

三、《若干政策》第(三)、(七)条提及的国家鼓励的重点软件企业享受税收优惠政策条件,除符合《中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告2021年第10号》规定的国家鼓励的软件企业条件外,还应至少符合下列条件

中的一项：

（一）专业开发基础软件、研发设计类工业软件的企业（具体领域说明见附件 2，下同），汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入（其中相关信息技术服务是指实现软件产品功能直接相关的咨询设计、软件运维、数据服务，下同）不低于 5000 万元；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 7%；

（二）专业开发生产控制类工业软件、新兴技术软件、信息安全软件的企业，汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入不低于 1 亿元；应纳税所得额不低于 500 万元；研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 8%；

（三）专业开发重点领域应用软件、经营管理类工业软件、公有云服务软件、嵌入式软件的企业，汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入不低于 5 亿元，应纳税所得额不低于 2500 万元；研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 7%。

四、《若干政策》第（六）条提及的集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业、线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业、集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的

化合物集成电路生产企业，以及财关税〔2021〕4号文提及的集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业享受税收优惠政策条件如下：

- （一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；
- （二）符合国家布局规划和产业政策；
- （三）具有保证产品生产的手段和能力；
- （四）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

五、《若干政策》第（六）条提及的先进封装测试企业享受税收优惠政策条件如下：

- （一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；
- （二）符合国家布局规划和产业政策；
- （三）汇算清缴年度企业先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3维封装）规划产能占总规划产能比例，按封装产品颗粒数或晶圆数（折合8英寸）计算不低于40%；
- （四）具有保证产品生产的手段和能力；
- （五）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

六、《若干政策》第（八）条提及的集成电路重大项目企业享

受税收优惠政策条件，除承建企业应符合本通知第四、五条的相对应规定条件外，项目还应符合下列对应条件中的一项：

（一）芯片制造类重大项目，需同时满足以下条件：

1.符合国家布局规划和产业政策；

2.对于不同工艺类型芯片制造项目，需分别满足以下条件：

（1）对于工艺线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器项目，固定资产总投资额需超过 80 亿元，规划月产能超过 1 万片（折合 12 英寸）；

（2）对于工艺线宽小于 0.25 微米（含）的模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅工艺等特色芯片制造项目，固定资产总投资额超过 10 亿元，规划月产能超过 1 万片（折合 8 英寸）；

（3）对于工艺线宽小于 0.5 微米（含）的基于化合物集成电路制造项目，固定资产总投资额超过 10 亿元，规划月产能超过 1 万片（折合 6 英寸）。

（二）先进封装测试类重大项目，需同时满足以下条件：

1. 符合国家布局规划和产业政策；

2. 固定资产总投资额超过 10 亿元；

3. 封装规划年产能超过 10 亿颗芯片或 50 万片晶圆（折合 8 英寸）。

附件 2

重点集成电路设计领域和重点软件领域

一、重点集成电路设计领域

如业务范围涉及多个领域，仅选择其中一个领域进行申请。选择领域的销售（营业）收入占本企业集成电路设计销售（营业）收入的比例不低于 50%。

- （一）高性能处理器和 FPGA 芯片；
- （二）存储芯片；
- （三）智能传感器；
- （四）工业、通信、汽车和安全芯片；
- （五）EDA、IP 和设计服务。

二、重点软件领域

如业务范围涉及多个领域，仅选择其中一个领域进行申请。选择领域的软件产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入（其中相关信息技术服务是指实现选择领域软件产品功能直接相关的咨询设计、软件运维、数据服务）占本企业软件产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入的比例不低于 50%。企业拥有所选择领域相应的发明专利不少于 2 项（企业为第一权利人），相应领域计算机软件著作权登记证书不少于 2 项（均应具备对应的测试报告）。

（一）基础软件：操作系统、数据库管理系统、中间件、通用办公软件、固件（BIOS）、开发支撑软件、少数民族语言文字编辑处理软件。

（二）研发设计类工业软件：虚拟仿真系统、计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、建筑信息模型（BIM）、产品数据管理（PDM）软件。

（三）生产控制类工业软件：工业控制系统、制造执行系统（MES）、制造运行管理（MOM）、调度优化系统（ORION）、先进控制系统（APC）、安全仪表系统（SIS）、可编程控制器（PLC）。

（四）新兴技术软件：分布式计算、数据分析挖掘、可视化、数据采集清洗等大数据软件，人机交互、通用算法软件、基础算法库、工具链、机器学习和深度学习框架等人工智能软件，信息系统运行维护软件，超级计算软件，区块链软件，工业互联网平台软件，云管理软件，虚拟化软件。

（五）信息安全软件：信息系统安全、网络安全、密码算法、数据安全、安全测试等方面的软件。

（六）重点行业应用软件：面向党政机关、国防、能源、交通、物流、通信、广电、医疗、建筑、制造业、应急、社保、农业、水利、教育、金融财税、知识产权、检验检测、科学研究、公共安全、节能环保、自然资源、城市管理、地理信息领域的专业应用软件。

（七）经营管理类工业软件：企业资源计划（ERP）、供应链管

理（SCM）、客户关系管理（CRM）、人力资源管理（HEM）、企业资产管理（EAM）、产品生命周期管理（PLM）、运维综合保障管理（MRO）软件及相关云服务。

（八）公有云服务软件：大型公有云 IaaS、PaaS 服务软件。

（九）嵌入式软件（软件收入比例不低于 50%）：通信设备、汽车电子、交通监控设备、电子测量仪器、装备自动控制、电子医疗器械、计算机应用产品、终端设备等嵌入式软件及嵌入式软件开发环境相关软件。

（以上部分软件名词涵盖范围可参考国家标准 GB/T 36475 软件产品分类）

附件3

享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表

| 序号 | 企业或项目类型 | 材料清单（复印件须加盖企业公章） |
|----|------------------------------|--|
| 一 | 享受《若干政策》第（一）条的集成电路生产企业或项目 | <ol style="list-style-type: none">1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）2.项目备案文件（备案表）；（可提供相应查询网址）3.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料；4.企业主要工艺、产品列表（名称/规格）；5.企业拥有与主营产品相关的发明专利等证明材料；6.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）和集成电路制造销售（营业）收入、自有集成电路产品制造销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；研究开发费用按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；7.与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；8.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）；9.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。 |
| 二 | 享受《若干政策》第（三）、（七）条的重点集成电路设计企业 | <ol style="list-style-type: none">1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料；3.企业开发销售的主要产品和服务列表（名称/重点领域/对应销售（营业）收入规模）；4.企业拥有与主营产品相关的不少于8项的已授权发明专利（企业为第一权利人）、布图设计登记、计算机软件著作权登记证书的证明材料； |

| 序号 | 企业或项目类型 | 材料清单（复印件须加盖企业公章） |
|----|-------------------------|--|
| | | <p>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）和集成电路设计销售（营业）收入、集成电路自主设计销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；研究开发费用按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；</p> <p>6.第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；</p> <p>7.税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料；</p> <p>8.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料；</p> <p>9.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。</p> |
| 三 | 享受《若干政策》第（三）、（七）的重点软件企业 | <p>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）</p> <p>2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料；</p> <p>3.企业开发销售的主要软件产品列表（名称/重点领域/对应销售（营业）收入规模）；其中申报公有云服务软件企业应明确区分列明企业公有云、私有云、混合云收入；</p> <p>4.企业具有所申报领域相应的已授权发明专利不少于2项（企业为第一权利人），相应领域计算机软件著作权登记证书不少于2项（均应具备对应的测试报告）的证明材料；</p> <p>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）和软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入、软件产品自主开发销售（营业）收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表；研究开发费用按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告；其中申报嵌入式软件企业应明确企业软硬件收入情况，并提供合同、发票等软件收入比例不低于50%的证明材料（不要求提供全部合同，仅需提供能证明符合申报条件的大额合同及合同中的必要内容）；</p> <p>6.汇算清缴年度与申报领域相关的合同列表（包含甲乙方、单价、总金额、交易内容、签约和付款时间等信息），以及发票等销售凭证；</p> <p>7.与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件；</p> <p>8.税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料；</p> <p>9.企业具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境（如合法的开发工具等）的证明材料；</p> <p>10.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。</p> |

| 序号 | 企业或项目类型 | 材料清单（复印件须加盖企业公章） |
|----|---|---|
| 四 | 享受《若干政策》第（六）条的集成电路生产企业和财关税〔2021〕4号文提及的关键原材料、零配件生产企业 | 1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址） 2.项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址）； 3.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等），先进封装、测试企业需提供按封装产品颗粒数或晶圆数（折合8英寸）计算，先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3维封装）规划产能占总规划产能比例不低于40%的证明材料； 4.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。 |
| 五 | 享受《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目 | 1.项目企业对应类别集成电路企业条件材料清单； 2.固定资产总投资额相关证明材料； 3.项目开工时间、拟竣工时间、备案时间、项目类型、产品类型、工艺线宽、总规划产能、先进封装测试规划产能、2020年7月27日后申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备进口时间、进口设备总金额、进口环节增值税额的相关证明材料； 4.省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求出具的其他材料。 |

注：上述企业类型、材料清单依据国发〔2020〕8号文制定，材料模板请询省级发展改革委（工业和信息化主管部门），填报说明见信息填报系统。

附件 4

企业重大变化情况表

原企业信息

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-------|---------------------|----------------------------|--|
| 企业名称（中文） | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | | | | | |
| 类型 | | | | | | |
| 注册资本 | | | | | | |
| 成立日期 | | | | | | |
| 营业期限 | | | | | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 联系地址 | | | | | 邮政编码 | |
| 联系人 | 手机 | | 座机 | | 电子邮箱 | |
| 企业性质 | <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | |
| 是否上市企业 | <input type="checkbox"/> 是 (上市地点、日期、代码 _____) | | | | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 是否高新技术企业 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (非必填) | 高新技术 企业认定 日期 | (非必填) | 高新技术 企业认定 证书号 | (非必填) | |

变更后企业信息

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 企业名称（中文） | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | | | | | |
| 类型 | | | | | | |
| 注册资本 | | | | | | |
| 成立日期 | | | | | | |
| 营业期限 | | | | | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 变更原因 | (包括企业或项目发生更名、分立、合并、重组以及主营业务重大变化等情况) | | | | | |
| 承诺 | (承诺不以变更企业名称方式重复享受相关政策优惠。) | | | | | |

注：附新旧企业法人营业执照（副本）扫描件，能够说明变更情况的具有法律效力的证明材料及省级发展改革委（工业和信息化主管部门）要求的其他说明材料。

国家发展改革委办公厅

2023年3月20日印发

